

Markt&Technik
DIE ZEITUNG FÜR ELEKTRONIK, KI UND INFORMATIONSTECHNIK

Messezeitung productronica

Das Leitmedium zur Messe

**Official
premium
partner**



Das Leitmedium
für die Leitmesse

Exklusive Vorteile, die Ihnen nur die
einzige offizielle Messezeitung zur
productronica 2025 bietet

Erscheinungstermin
18.11.-21.11.2025



Gesamtauflage
Über 130.000 Exemplare

Anzeigenschluss:
27.10.2025





**Die offizielle
Messezeitung**

Published by **Markt & Technik** World's leading trade fair for electronics development and production.



productronica-Premiere: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung präsentiert den »Inno Truck«. Dieser zum Forschungslabor umgebaute LKW soll auf spielerische Weise das Interesse für technologischen Können und gleichzeitig Nachwuchskräfte für technische Berufe begeistern. Der InnoTruck steht zwischen den Hallen A1 und B1.

Bild: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Highlights

Exhibition Map & Events pp. 4-6

ROI Optimization in Electronics Manufacturing p. 8

Test & Measurement pp. 10-11

Semiconductor Technology pp. 14, 17

PCB Assembly pp. 15-16, 22

Electronics Manufacturing Services p. 18

Soldering pp. 19-20

PCB Inspection p. 23

Visit the WEKA stand at productronica!
Hall A2, Booth 577

New test methods from ERS

Test costs will fall significantly

For the first time, complex ICs can now be tested under voltage and temperature not only in the final test, but also at the wafer-level. This increases the yield and significantly reduces costs. "This makes chiplet-based processors affordable, while simpler microcontrollers for cars can now be produced more cost-effectively," says Klemens Reitinger, CTO of ERS.

Markt & Technik: ERS has so far been very successful with air-cooled chuck systems developed in-house and has consistently emphasized the advantages of this technology compared to liquid-cooled chucks. Just in time for Semicon Europa, ERS is now presenting a new water-cooled chuck here at the fair. Why the change of heart? Klemens Reitinger: This may sound like a change of heart at first, but in fact it is not. We remain convinced that air-cooled thermal chuck systems are the better option for the vast majority of applications, and we basically stick to our philosophy of using air cooling wherever possible. But above all: the fact that the new chucks are liquid-cooled is not the innovation but rather just a by-product, so to speak.

So what is the really new development that ERS is presenting at Semicon Europa? I think the best place to start is at the top level, the application. All manufacturers of processors and microcontrollers, but in particular manufacturers of high-end CPUs, GPUs and AI processors, regardless of whether they are IDMs or foundries, are facing a huge problem: You cannot perform a full wafer-level test on these ICs. Whether they work or not is only revealed during final test, i.e. after the ICs have been separated. However, being able to sort out faulty ICs only after the final test costs much more than if they could be identified on the wafer in advance.

Why is this especially true of the high-end devices? In principle because these devices are no longer integrated monolithically. Instead, manufacturers produce individual functional blocks separately in the most suitable available process technology. These so-called chiplets are then integrated into housing, using advanced packaging techniques. For this to be cost-effective, the chiplets must be known Good Dies. If they can only be tested for their functionality in the package during the fi-



Klemens Reitinger, CTO of ERS

➔ Page 7

**»Reinraum-Blase«
für den Arbeitsplatz**



Bild: Deep Data System

Das von Klepp Absauganlagen vertriebene kompakte Reinraumgerät »DAIR« verbessert die Luftreinheit am Arbeitsplatz. Es hält die Arbeitsflächen frei von Schwebstoffen und erzeugt zugleich eine unsichtbare »Reinraum-Blase« am Arbeitsplatz. Das mobile Absauggerät DAIR wartet mit einer laminaren Reinluftströmung von 0,5-0,6 m/s auf und absorbiert Partikelgrößen > 0,3 µm. Zudem bläst es konstant Reinluft über den Arbeitsplatz, wobei der laminare Luftstrom nicht zu

➔ Seite 9

www.markt-technik.de

Markt & Technik Die offizielle Messezeitung **1**

10 Tausend Printexemplare

Ausstellerverteilung

Verteilung an alle Ausstellerstände

Besucherverteilung

Exklusive Verteilung in den Eingängen an allen drei Tagen

Fachpressestand

Auslage an allen drei Tagen

Hotelverteilung

ca. 40 Hotels rund um die Messe



120 Tausend

E-Paper Empfänger

Nationale und internationale
Fachkontakte

Beilage

Heben Sie sich von klassischen Anzeigen ab und platzieren Sie Ihre Botschaft physisch in den Händen der Leser

Jetzt buchen



Die offizielle

Messezeitung



Published by Markt & Technik

World's leading trade fair for electronics development and production.



productronica-Premiere: Das Bundesministerium für Bildung und Forschung präsentiert den 'InnoTrack'. Dieser zum Forschungsplatz umgebaute LEW soll auf spielerische Weise das Interesse für Technologie fördern und gleichzeitig Nachwuchskräfte für technische Berufe begeistern. Der InnoTrack steht zwischen den Hallen A2 und B1.

Bild: Bundesministerium für Bildung und Forschung

Highlights

- Exhibition Map & Events pp. 4-6
- ROI Optimization in Electronics Manufacturing p. 8
- Test & Measurement pp. 10-11
- Semiconductor Technology pp. 14, 17
- PCB Assembly pp. 15-16, 22
- Electronics Manufacturing Services p. 18
- Soldering pp. 19-20
- PCB Inspection p. 23

Visit the WEKA stand at productronica!
Hall A2, Booth 577

New test methods from ERS

Test costs will fall significantly

For the first time, complex ICs can now be tested under voltage and temperature not only in the final test, but also at the wafer-level. This increases the yield and significantly reduces costs. "This makes chiplet-based processors affordable, while simpler microcontrollers for cars can now be produced more cost-effectively," says Klemens Reitingner, CTO of ERS.

Markt & Technik: ERS has so far been very successful with air-cooled chuck systems developed in-house and has consistently emphasized the advantages of this technology compared to liquid-cooled chucks. Just in time for Semicon Europa, ERS is now presenting a new water-cooled chuck here at the fair. Why the change of heart? Klemens Reitingner: This may sound like a change of heart at first, but in fact it is not. We remain convinced that air-cooled thermal chuck systems are the better option for the vast majority of applications, and we basically stick to our philosophy of using air cooling wherever possible. But above all: the fact that the new chucks are liquid-cooled is not the innovation but rather just a by-product, so to speak.

So what is the really new development that ERS is presenting at Semicon Europa? I think the best place to start is at the top level, the application. All manufacturers of processors and microcontrollers, but in particular manufacturers of high-end CPUs, GPUs and AI processors, regardless of whether they are IDMs or foundries, are facing a huge problem: You cannot perform a full wafer-level test on these ICs. Whether they work or not is only revealed during final test, i.e. after the ICs have been separated. However, being able to sort out faulty ICs only after the final test costs much more than if they could be identified on the wafer in advance. Why is this especially true of the high-end devices?

In principle because these devices are no longer integrated monolithically. Instead, manufacturers produce individual functional blocks separately in the most suitable available process technology. These so-called chiplets are then integrated into housing, using advanced packaging techniques. For this to be cost-effective, the chiplets must be Known Good Dies. If they can only be tested for their functionality in the package during the fi-

➔ Page 7



Klemens Reitingner, CTO of ERS

»Reinraum-Blase« für den Arbeitsplatz



Das von Klepp Absauganlagen vertriebene kompakte Reinraumgerät »DAIR« verbessert die Luftreinheit am Arbeitsplatz. Es hält die Arbeitsflächen frei von Schwebstoffen und erzeugt zugleich eine unsichtbare »Reinraum-Blase« am Arbeitsplatz. Das mobile Absauggerät DAIR wartet mit einer laminaren Reinluftströmung von 0,5-0,6 m/s auf und absorbiert Partikelgrößen > 0,3 µm. Zudem bläst es konstant Reinluft über den Arbeitsplatz, wobei der laminare Luftstrom nicht zu

Bild: Klepp Absauganlagen

Markt & Technik Die offizielle Messezeitung 1

Messespiegel

Führen Sie die Messebesucher mit Ihrer standardisierten Anzeige im Messespiegel direkt auf Ihren Stand. Wir benötigen nur Ihr Firmenlogo und die Standangabe.

790 €

productronica 2021

73 x 65 mm Messespiegel

Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand
Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand
Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand
Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand	Firmenlogo Wir sind dabei! Halle/Stand

Bild: Klepp Absauganlagen

Jetzt buchen

Preise & Termine

Format	Preise 4c	
1/1	10.960 €	
9/16 (Junior Page)	6.490 €	
1/2 hoch oder quer	5.780 €	
1/3 hoch oder quer	3.860 €	
1/4 hoch oder quer	2.960 €	
1/4 2-spaltig	1.940 €	
1/6 quer	1.500 €	
1/8 2-spaltig	800 €	
1/8 4-spaltig	10,80 €	
1/16 hoch	11.670 €	
mm-Preis, 1-spaltig (mind. 20 mm)	13.970 €* <td></td>	
2. US oder 4. US	44,80 €	
Titelflappe	19.540 €* <td></td>	
Inselanzeige mm-Preis (50 bis 80 mm)	6.500 €* <td></td>	
Banderole		
Post-it		
Termine		
Erscheinungstermin	18.11. – 21.11.2025	
Anzeigenschluss	27.10.2025	
Druckunterlagenschluss	30.11.2025	

*nicht rabattfähig

Kundenspezifische Gehäuse

Warum modifizierte Gehäuse oft die bessere Wahl sind

Die Anforderungen an Gehäuse sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Während früher standardisierte Lösungen ausreichten, sind heute komplexe, oft kundenspezifische Designs gefragt – freilich ohne die Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren. Wie setzen Hersteller das um?

Der Trend geht weiter eindeutig in Richtung kundenspezifischer Gehäuse, bestätigt Ole Pfoch von Apra Norm. Der Grund dafür liegt in der zunehmenden Spezialisierung elektronischer Geräte, die nicht nur technisch, sondern auch optisch perfekt auf die Anwendung abgestimmt sein müssen. Dies betrifft sowohl die Auswahl der Materialien als auch die Integration von Funktionen wie Display- oder Touchlösungen. Zugleich gewinnen Schutzanforderungen an Bedeutung: Gehäuse müssen heute nicht nur Staub und Wasser abweisen (IP-Schutz), sondern auch stoßfest, UV-beständig und temperaturresistent sein.

Kundenspezifisch oder modifizierter Standard?

Die Individualisierung nach Kundenwunsch (kundenspezifisch) wird häufig als dominanter Allgemeintrend genannt. Faktisch aber nicht, ohne nach der Wirtschaftlichkeit zu fragen: Lässt sich mit modifizierten Lösungen der Kundenwunsch schnell und günstiger erfüllen?

Bopla zum Beispiel setzt erstmalig darauf, bestehende Standardgehäuse an Kundenanforderungen anzupassen. Dies ermögliche eine wirtschaftliche Lösung für den Kunden, vor allem bei kleinen Stückzahlen, erklärt Thomas Lücke, Sales Director von Bopla. Und bestätigt: „Unser Fokus liegt auf modifizierten Standardlösungen, da sie viele Kundenanforderungen ohne hohe Investitionskosten abdecken und schnell verfügbar sind.“ Während die Nachfrage nach kundenspezifischen Gehäusen wächst, bleibt der modifizierte Standard für viele Hersteller eine praktikable Alternative. Insbesondere für kleinere Serien ist dies eine wirtschaftliche Lösung. Größere Serien dagegen profitieren von vollständig maßgeschneiderten Designs, da durch

optimierte Produktionskonzepte die Stückkosten gesenkt werden können.

Trotzdem wächst auch bei Bopla die Nachfrage nach vollständig kundenspezifischen Lösungen. Dabei sei die größte Herausforderung, individuelle Lösungen wirtschaftlich umzusetzen. „Besonders bei kleinen Stückzahlen, Lücken. Zudem stehen Hersteller unter ständigem Preisdruck und müssen gleichzeitig steigende regulatorische Anforderungen und damit verbundenen Dokumentationsaufwand bewältigen.“

Maximilian Schober von Polyrack nennt ähnliche Herausforderungen: „Je leistungsfähiger die Elektronik, desto komplexer die Anforderungen – sei es in Bezug auf Schutz, Kühlung oder Integration von Schnittstellen.“ Während Polyrack ebenfalls auf Individualisierung setzt, betont Schober die Schwierigkeiten, die durch Zertifizierungsprozesse entstehen. Änderungen in der Serienfertigung erfordern oft eine erneute Zulassung, was den Entwicklungsaufwand erhöht.

Wärmemanagement als Schlüsselfaktor

Mit der steigenden Rechenleistung wächst auch die Herausforderung des Wärmemanagements. Besonders in luftlosen Systemen mit hoher Taktfrequenz müssen Gehäuse Wärme effizient ableiten.

Lisa Pichler von Phoenix Contact erklärt die Integration von Kühlkörpern und ausgeklügeltem Thermomanagement ist essenziell, um Überhitzung zu vermeiden. „Dazu kommt: Passive Kühlung wie optimierte Materialwahl oder Flüssigkühlsysteme.“

Produkt-Highlight

Nur 12,5 mm hoch, aber stark!



Für die steigenden Anforderungen an das Wärmemanagement in elektronischen Bauteilen kommt der zuverlässige Radiallüfter LY608 von SEPA zur richtigen Zeit. Mit den Maßen 65 mm x 70 mm x 12,5 mm eignet er sich unter anderem hervorragend zum Entwärmen flacher Gehäuse oder zum Anblasen engmaschiger Kühlkörper (Prozessorkühlung). Er fördert bis zu 11m³ Luft pro Stunde und baut im Extremfall bis zu 110 Pa Druck auf. Ein besonderes Feature ist der IP-Schutz. Durch eine schutzlackierte Leiterplatte ist es möglich den LY608 mit IP 55 zu liefern.

SEPA Europa, www.sepa-comps.com, Tel. 04324 1049300



1.910 €

DAS PRODUKT HIGHLIGHT

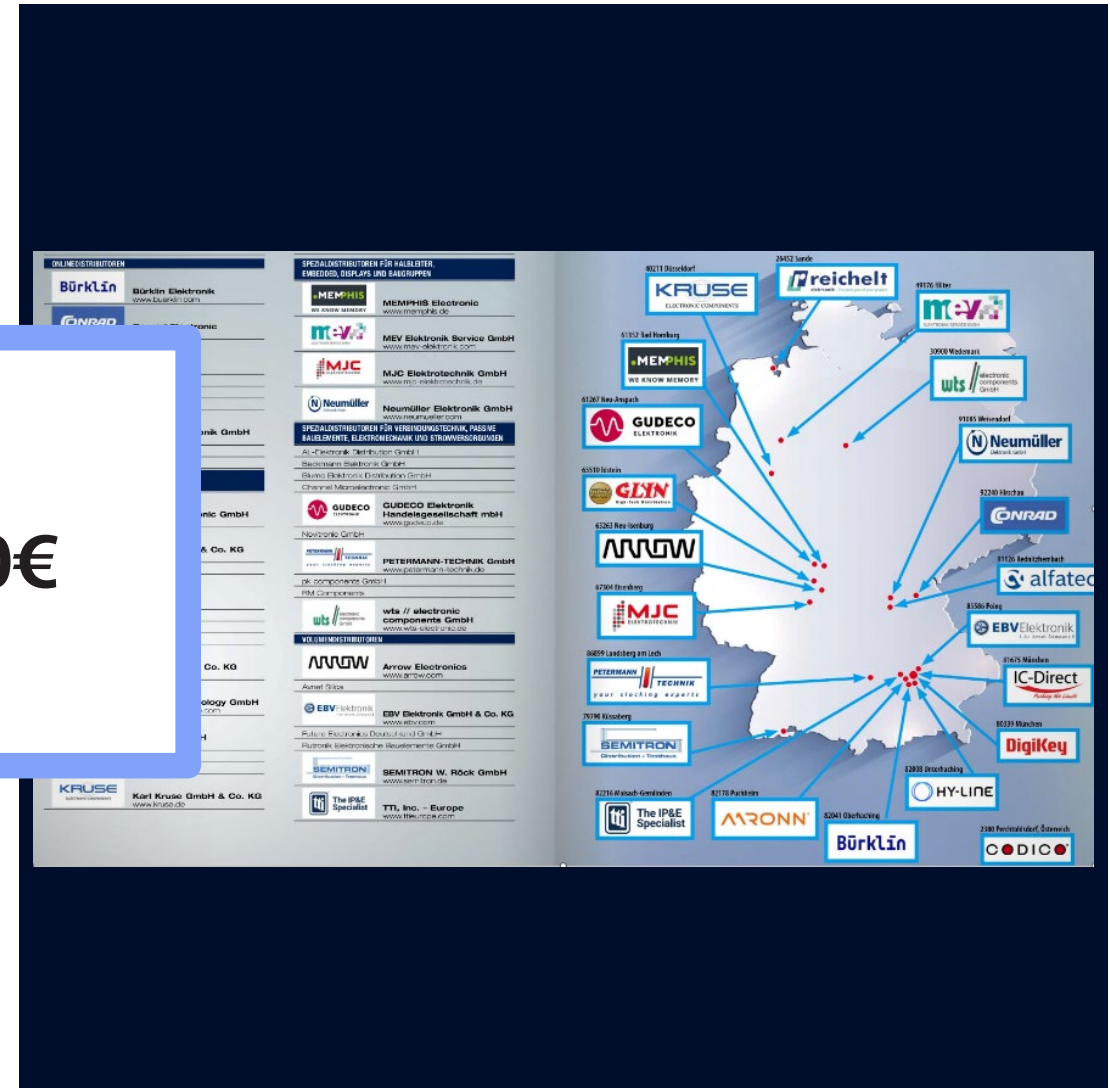
Ihre Produktmeldung direkt im redaktionellen Kontext, hervorgehoben durch Ihr Logo und die Überschrift „Produkt-Highlight“ ca. 650 Zeichen + Logo + Schmuckbild. Das Layout erfolgt über Componeers.

Druckunterlagen bis 04. November

DIE WICHTIGSTEN Elektronik- fertiger DES LANDES

Buchen Sie Ihr Logo in der
Übersichtskarte* „Elektronik-
Fertiger-Firmen“. Die
Übersicht erscheint in der
productronica Messezeitung
in der Gesamtauflage von
130.000 Exemplaren.

490€





über 6 Millionen Seitenaufrufe

in den letzten 12 Monaten*

*Quelle: IVW 30.04.2024 - 01.05.2025

Newsletter zur Messe

14.11.2025 Vorberichte productronica

18.11.2025 Berichte productronica

ca. 15.000 Empfänger!



elektroniknet.de

Digital

**Werben in glaubwürdigem
Umfeld!**

elektroniknet.de genießt in der Branche ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit und redaktioneller Qualität: 91 % der Nutzer bewerten die Plattform als glaubwürdig, 98 % finden die Informationen verlässlich.

(Quelle: Nutzerbefragung 2021)



Messeausgabe zur productronica

Markt&Technik 45 am 14.11.2025
Anzeigenschluss 31.10.
Druckunterlagenchluss 04.11.



Markt&Technik

Print

**Machen Sie auf sich
aufmerksam!**

Die Messeausgabe und die
productronica Messezeitung liegen
in den Messehallen aus. Zusätzlich
bietet der Hallenplan die
Möglichkeit, Besucher direkt zu
Ihnen an den Stand zu führen.



Beispielvideo

Videoproduktion

Optionale Bewerbung
über unsere Kanäle

2.490 €

(nicht rabattfähig)

- telefonisches Kurzbriefing
- max. 60 Minuten Drehzeit auf Ihrem Messestand
- Postproduktion und Schnitt des Clips bis Kundenabnahme für einen Clip mit max. 5 Minuten Länge
- inkl. Kamera und Ton für Webqualität in Full HD / 4K
- Veröffentlichung des Videos in der Mediathek
- Uneingeschränkte Nutzung des Videomaterials



elektroniknet.de

Messe-Clip

**Machen Sie mehr aus Ihrem
Messeauftritt!**

Nutzen Sie Ihren Messeauftritt und lassen Sie ein professionelles Video erstellen, um Ihren Messeerfolg oder Produktneuheiten in Bild und Ton festzuhalten.

Awareness-Lead-Paket zur Messe

Wir bringen unsere Besucher zu Ihnen an den Stand

Auf dem Componeers-Stand erwartet die Besucher unser Glücksrad mit vielen tollen Gewinnen.

Ein sicherer Besuchermagnet und für Sie die perfekte Möglichkeit, mit Ihrem Logo im Vorfeld, während und nach der Messe zu werben. Ab Ihrer Zusage integrieren wir Ihr Firmenlogo in alle Print- und Online- Werbemaßnahmen.

VOR DER MESSE

Online Banner:

- Namentliche Nennung als Partner und mit Logo auf elektroniknet.de und in mindestens 5 Newslettern
- Je Newsletter ca. 15.000 Empfänger

Print Anzeige:

- Markt&Technik 45, Gesamtauflage Ausgabe ca. 38.000
- Productronica Messezeitung, Gesamtauflage ca. 130.000

WÄHREND DER MESSE

- **Logopräsenz** auf dem Glücksrad
- **Logopräsenz** auf den Rollups zur Bewerbung
- Partner stellen Preise (ca. 500 Stk.) zur Verlosung zur Verfügung (in Absprache mit Componeers)

NACH DER MESSE

- Mailing an alle Teilnehmer mit namentlicher Nennung der Partner mit Logo



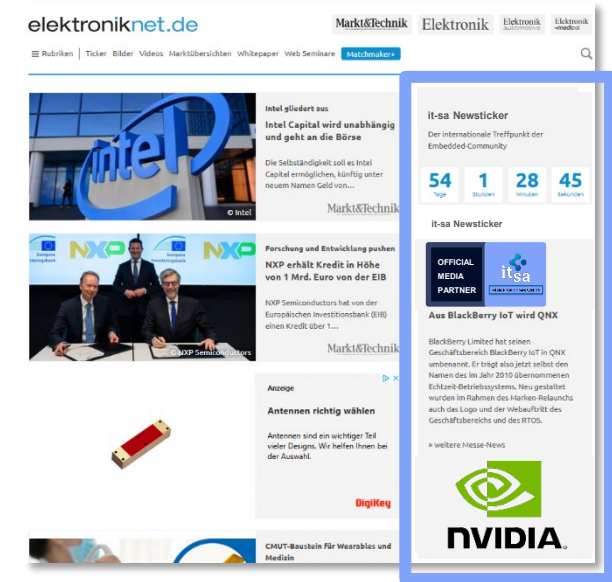
2.990,- Euro
(nicht rabattfähig)

Buchungsschluss Werbepaket
24. Oktober 2025

Countdown und Newsticker

Exklusivplatzierungen

- Aufmerksamkeitsstarke Platzierung mit erhöhter Sichtbarkeit durch prominente Platzierung auf der Startseite elektroniknet.de
- Zielgruppenspezifische Reichweite zur Ansprache potentieller Kunden
- Direkte Verlinkung auf Ihre Homepage
- Steigerung der Markenbekanntheit
- Ihr Logo in direkter Verbindung zur productronica



productronica-Countdown

- Exklusive Werbeform auf der Startseite von elektroniknet.de
- Ihr Logo mit Verlinkung bis 18. November 2025



€ 4.900,-

productronica-Newsticker

- Exklusive Werbeform auf der Startseite von elektroniknet.de
- Ihr Logo mit Verlinkung bis 21. November 2025



€ 4.900,-

Sie haben Fragen?

Wir beraten Sie gerne!



Carolin Schlüter

Sales Director Electronics

+49 89 25556-1570

cschlueter@componeers.net



Christian Stadler

Sales Director New Electronics

+49 89 25556-1375

cstadler@componeers.net



Malina Colombo

Key Account Managerin

+49 89 25556-1382

mcolombo@componeers.net



Martina Greulich

Key Account Managerin

+49 89 25556-1576

mgreulich@componeers.net



Emilia Dietrich

Account Managerin

+49 89 25556-1574

edietrich@componeers.net



Rosie Böhm

Anzeigenassistentz

+49 89 25556-1307

rboehm@componeers.net